



移动金融技术服务认证

Technology Certification of Mobile Financial Service

服务认证证书

注册号: CFNR201902810027

兹证明:

华为技术有限公司

(注册地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼)

申请的安全芯片符合《JR/T 0089.1-2012 中国金融移动支付 安全单元 第1部分: 通用技术要求》、《JR/T 0089.2-2012 中国金融移动支付 安全单元 第2部分: 多应用管理规范》、《JR/T 0098.2-2012 中国金融移动支付 检测规范 第2部分: 安全芯片》和《移动金融技术服务认证实施规则-安全芯片》(V2.0)的相关要求, 特发此证。

芯片型号和硬件/固件版本号:

Kirin990 HiSEC V600/V6.00

研发中心名称及地址一:

华为西安研究所
陕西省西安市高新区锦业路127号华为基地

研发中心名称及地址二:

华为上海研究所
上海市浦东新区新金桥路1599号东方万国E2

研发中心名称及地址一:

台湾积体电路制造有限公司
中部科学工业园区科雅六路1号 (Fab15厂)

研发中心名称及地址二:

SPIIL 中科厂
台中市大雅区科雅路19号

研发中心名称及地址三:

日月光 高雄厂
高雄市楠梓加工出口区西5街10号

证书的最新状态请查询本认证机构网站 (www.icfnr.org)

及国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn)



第一次
监审

第二次
监审

颁证日期: 2019年08月27日

有效期至: 2022年08月26日

初次认证: 2019年08月27日

北京中金国盛认证有限公司

中国·北京市西城区右安门内大街新安南里甲1号